CREATION & INNOVATION
Forever

株式会社タカトリ
The Power of "T"
Technology Trust Teamwork

ものづくり革新本部
電子機器カンパニー
新素材機器カンパニー

2026 年 12 月 9 日～11 日に開催されます「SEMICON Japan 2026」に出展いたします、皆様のご来場お待ちしております。

出　展　内　容

【　新機種 パネルレベルパッケージ対応　PLP-700　】
サイズが最大 700 ㎜×700 ㎜に対応するパネルレベルパッケージ用の最新設備(PLP-700)のパネル展示を中心に、半導体設備のご提案を致します。

【　新機種 12 インチ用マルチワイヤーソー　MWS-SiC12F　】
大口径インゴット切断用の最新型マルチワイヤーソー「MWS-SiC12F」（Φ12 インチ対応、最大 14 インチまで）を中心に、高精度且つ高歩留まりな切断加工機のご提案を致します。

また、弊社ブースでは、ものづくり革新本部各部門の責任者による「お悩み事・意見交換会」を開催いたします。技術的なご相談から情報交換まで、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

＜会場＞
・株式会社タカトリブース　西館 1 階 ブース No. W2931

弊社お問い合わせ先 URL: https://www.takatori-g.co.jp
SEMICON JAPAN 2026 URL: Home - SEMICON Japan 2026